

深圳市联得自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2025-002

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他 券商策略会</div></div>                                                                              |
| 参与单位名称及人员姓名   | Dragonstone Capital、Capstone Capital、中信建投证券共 5 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2025 年 2 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 券商策略会现场（香港）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、董事会秘书：刘雨晴女士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、介绍公司概况</div> <div>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</div> <div>二、投资者会议问答交流</div> <div>Q1：公司在海外市场有哪些客户？</div> <div>A1：在海外市场，公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源，并建立了良好的合作关系。公司在该行业的布局逐渐在订单中变现，特别是公司与国外大客户的深度合作，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。</div> <div>Q2：公司在三折屏供应链中提供哪些设备？</div> <div>A2：公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。</div> <div>Q3：公司在 VR/AR/MR 显示领域有哪些产品和客户？</div> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>A3:</b> 公司通过不断推陈出新打破技术壁垒,持续自主研发创新,研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域,公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备,相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。</p> <p><b>Q4: 公司在半导体先进封装领域有哪些布局?</b></p> <p><b>A4:</b> 公司一直积极布局半导体领域,已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。在先进封装领域,公司有针对显示驱动芯片键合设备,COF 倒装设备,该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势,积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。</p> <p><b>Q5: 公司是否考虑通过并购重组来扩大经营?</b></p> <p><b>A5:</b> 公司一直持续关注相关行业动态,积极寻求整合优质资源的机会,将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向,公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策。</p> <p><b>Q6: 公司未来如何继续拓宽销售渠道?</b></p> <p><b>A6:</b> 公司持续推动全球化业务的布局工作,在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下,积极开拓海外销售市场。公司凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系,获得了海外大客户的广泛认可,并达成了深度合作。未来公司将持续开拓海外销售市场,进一步拓宽销售渠道,不断推进公司业务发展,以良好的经营业绩回报广大投资者。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期       | 2025-2-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |